

EVG Introduces Next Generation EVG150 Resist Processing Platform – November 7, 2022

EVG, 차세대 EVG150 레지스트 처리 플랫폼 출시

- 강석오 기자
- 승인 2022.11.08 16:26
-



[데이터넷] MEMS, 나노기술, 반도체 시장용 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비 분야를 선도하는 EVG(EV Group)는 차세대 200mm 제품으로 EVG150 자동화 레지스트 처리 시스템을 출시했다고 밝혔다.

새로운 디자인의 EVG150 플랫폼은 이전 세대 플랫폼 대비 최대 80%까지 더 높은 생산성, 우수한 범용성, 50% 더 작은 풋프린트가 특징이다. 범용 플랫폼으로 신뢰할 수 있는 고품질 코팅 및 현상 공정이 가능해 첨단 패키징, MEMS, RF, 3D 센싱, 전력 반도체, 포토닉스를 비롯한 다양한 디바이스 및 애플리케이션에 적용할 수 있다. 새로운 장비는 우수한 생산성과 유연성 및 반복성을 통해 대량 생산과 산업용 개발 양쪽 모두의 까다로운 요구를 충족한다.

200mm 기판용 차세대 EVG150은 이전 세대 플랫폼의 업계 선도적인 특성을 그대로 유지하고 있다. 이러한 특성으로는 회전 및 분사 코팅, 현상, 베이킹 및 냉각 공정을 위해 맞춤형 모듈 구성이 가능한 완벽하게 자동화된 플랫폼, 극히 복잡한 형태의 컨포멀 코팅이 가능한 EVG 고유의 옴니스프레이(OmniSpray) 기술, 지속적으로 높은 생산성을 달성하도록 듀얼 엔드 이펙터 기능을 사용하는 정교하고 성능이 검증된 로봇 핸들링, 그리고 웨이퍼 에지 핸들링과 휘거나 뒤틀린 웨이퍼 또는 박막 웨이퍼를 취급할 수 있는 능력이 포함된다.

토마스 글린스너 (Thomas Glinsner) EVG 디렉터는 “레지스트와 패터닝은 반도체 제조에서 가장 반복적으로 사용되는 공정들이다. EVG는 리소그래피와 회전 및 분사 코팅 등의 공정 분야에서 다년간 쌓아온 전문성을 바탕으로 고객들의 극히 까다로운 요구를 충족하는 솔루션을 제공한다”며 “차세대 EVG150 시스템은 범용 플랫폼으로 새로운 차원의 생산성과 비용 상의 이점을 달성하도록 설계됐으며 전례 없이 뛰어난 유연성으로 다양한 애플리케이션의 레지스트 공정 요구를 충족한다”고 전했다.

저작권자 © 데이터넷 무단전재 및 재배포 금지

강석오 기자

다른기사 보기

출처 : 데이터넷(<http://www.datanet.co.kr>)

<http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=178117>